

漢民科技日本熊本據點啟用 加速在地供應鏈佈局

漢民科技在日本熊本新設的辦公據點，於 2024 年 4 月 15 日正式啟用。漢民日本今日下午於新建的辦公室舉辦開幕儀式，由漢民科技副董事長許金榮 (CY Shu) 與總經理陳溪新 (David Chen) 揭開序幕，參與賓客包含台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷、熊本縣知事當選人木村敬，以及多家在地企業夥伴。

因應客戶需求加上日本積極復興半導體產業，漢民於 2022 年決定在九州設立在日本的第一個據點。除了支援長期合作的客戶，亦努力在日本拓展包含碳化矽 (SiC) 等化合物半導體以及先進封裝的合作機會。

漢民科技子公司漢辰科技 (Advanced Ion Beam Technology, Inc. AIBT) 20 多年來持續研發生產低能量高電流離子佈植機 (Ion Implanter)，偕同半導體最大先進製程客戶共同推進二奈米製程設備，為台灣半導體前段製程設備的關鍵廠商。漢辰科技 iBlazar 採用業界標準的 Linear Scan，並融入最新技術 ISO Scan 與高效率晶片傳輸系統，具備卓越的粒子缺陷控制與高真空性能。

SiC 具備高電壓與高電流特性，特別適用於未來趨勢的電動車應用領域。日本是傳統汽車生產大國，漢民規劃在日本車用電子市場創造更多合作契機。在化合物半導體供應鏈中，漢民目前擁有完整的佈局，從 SiC 長晶、基板製造 (SiC Substrate)、EPI 製程設備 (SiC EPI CVD) 研發，到測試解決方案，漢民規劃成為國際汽車大廠穩定供貨的合作夥伴。

關於漢民科技

漢民科技成立於 1977 年，我們以半導體設備代理為起點，朝自主設備研發與前瞻科技邁步向前，提供客戶一流的產品與服務。40 多年來，漢民服務多家半導體設備大廠，並成功開發 ICP 電漿蝕刻機 (ICP Etcher)、離子植入機 (Ion Beam Implanter) 與有機化學氣相沉積 (MOCVD) 等設備，並深耕於化合物半導體材料，量產碳化矽基板 (SiC Substrate)。漢民的服務據點遍及台灣、美國、日本、新加坡、馬來西亞與中國大陸，員工總數超過 1200 人。更多資訊，請參考官網：<https://www.hermes.com.tw/>。

漢民

Hermes Epitek

新聞聯絡人：

蔡璦竹 Katie Tsai +886 919 439086 Katie.Tsai@hermes.com.tw